

PROCESOR INTEL® XEON® PLATINUM 8170

(35,75 MB pamięci cache, 2,10 GHz)



Dane techniczne

Niezbędne zasoby

Segment rynku pionowego	Server
Numer procesora	8170
Stan	Launched
Data rozpoczęcia	Q3'17
Litografia	14 nm

Wydajność

Liczba rdzeni	26
---------------	----

Liczba wątków	52
Bazowa częstotliwość procesora	2.10 GHz
Maks. częstotliwość turbo	3.70 GHz
Cache	35.75 MB L3
TDP	165.0 W

Informacje dodatkowe

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych	No
--------------------------------------	----

Dane techniczne pamięci

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)	768 GB
	Rodzaje pamięci
DDR4-2666	
Maks. liczba kanałów pamięci	6
Obsługa pamięci ECC [†]	Yes

Opcje rozszerzeń

Skalowalność	S8S
Wersja PCI Express	3.0
Maksymalna liczba linii PCI Express	48

Dane techniczne pakietu

Obsługiwane gniazda	FCLGA3647
T _{CASE}	89°C

Wymiary obudowy 76.0mm x 56.5mm

Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków Aby uzyskać więcej informacji, między innymi na temat procesorów obsługujących technologię Intel HT, zobacz stronę pod adresem: MDDS

Technologie zaawansowane

Obsługa pamięci Intel® Optane™ † No

Technologia Intel® Speed Shift Yes

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 † No

Technologia Intel® Turbo Boost † 2.0

Technologia Intel® vPro † Yes

Technologia Intel® Hyper-Threading † Yes

Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Yes

Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Yes

Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Yes

Intel® TSX-NI

Yes

Intel® 64 † Yes

Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512

Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Yes

Niezawodność i bezpieczeństwo

Intel® AES New Instructions	Yes
Technologia Trusted Execution †	Yes
Funkcje Execute Disable Bit †	Yes